

ATRM-2300 省テープ剥離システム搭載 全自動保護テープ剥し機

Fully Automatic Backgrind Tape Removal System with the Tape-Saving Removal system.

【概要 - Outline -】

◆本装置は、保護テープを全自動で剥離を行う装置です。

This machine is to remove BG tape in fully automatic mode.

また、裏面をバックグラインドされた、TAIKO ウェーハにも対応しており、裏面、非接触での搬送、剥離は可能です。

Back-grind TAIKO wafer can be transferred and tape-removed without contacting backside.

【特長 - Features -】

◆薄厚ウェーハに対応

Applicable to Thin Wafers

◆安定・安全剥離システム

Stable and Safe Removal System

◆UV 照射機とのドッキング可能

Docking with UV irradiator

◆多様なテープウェーハに対応

Applicable to Various Type of Wafer and Tape



コスト大幅減少

Drastic Cost Reduction

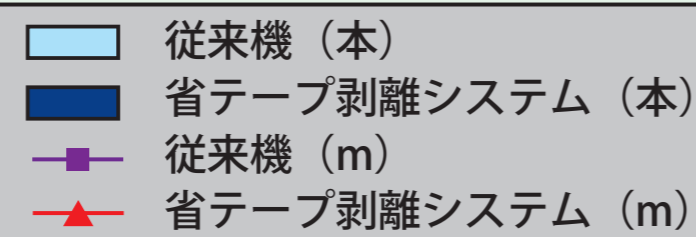
■条件生産量 Production

20,000 枚 / 月

20,000 units/month

(75 枚 / 時間 × 8 時間生産 × 30 日 = 18,000 枚 / 月)

(75 units/hour, 8hours/day, 30 days: 18,000 units/month)



■条件テープ使用量 Tape Usage:

①従来機 230 mm / 枚

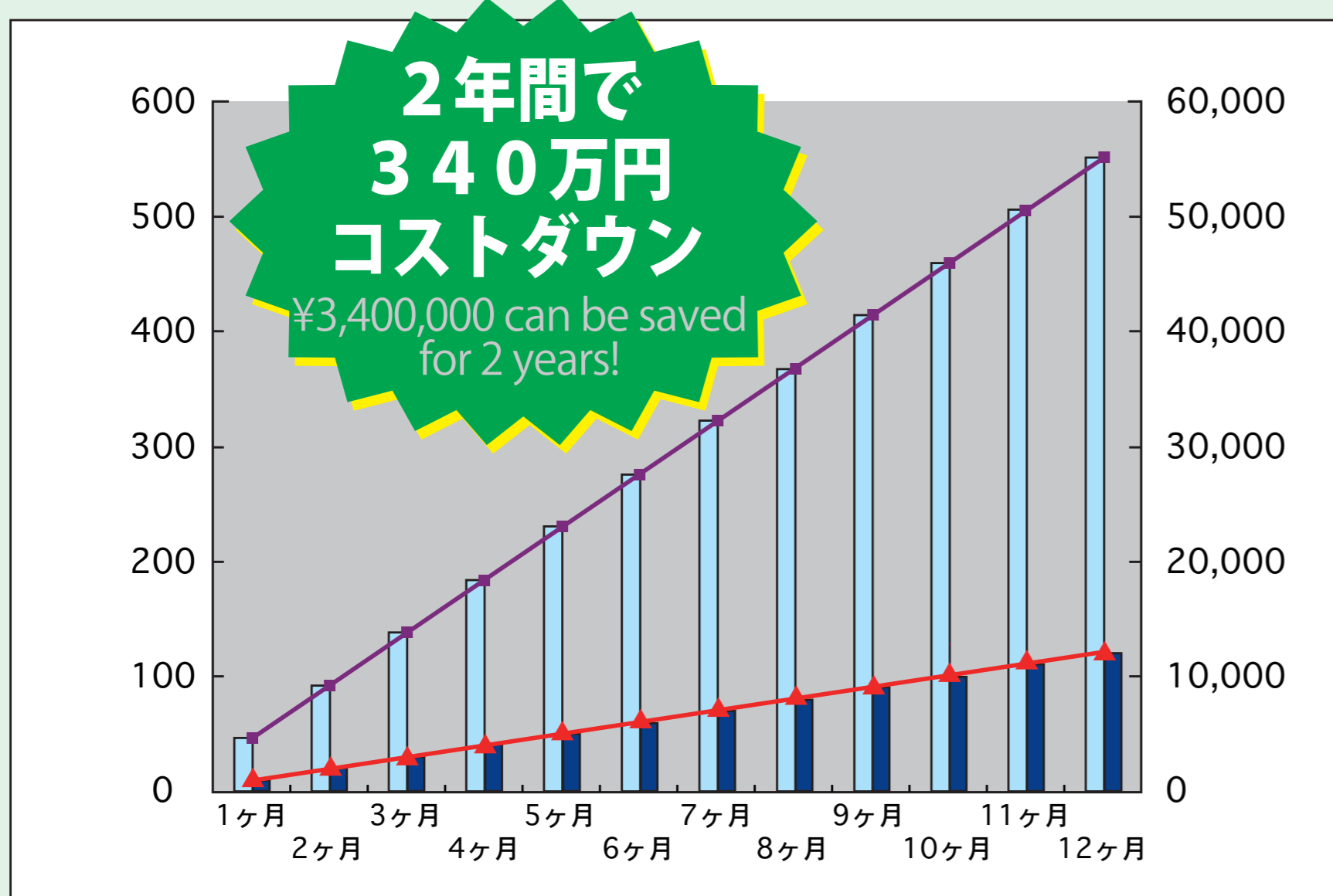
Conventional model: 230mm/unit

②省テープ剥離システム搭載機 50 mm / 枚

Model with tape-saving removal system: 50mm/unit

■条件テープ費用 Cost for Tape

¥ 4000 / 100m



仕様 Specification	ATRM-2300	
スループット Throughput	75 枚 / h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	4・5・6・8 inch (4・5・6inch or 5・6・8 inch)	
使用テープ幅 Tape Width	4・5・6 inch : 38 mm, 8 inch : 50・75 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 1.5KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5~0.8Mpa 90NI/min
	真空源 Vacuum source	-74Kpa
装置寸法 Demension	D 980 × W 1,140 × H 1,665 mm	
重量 Weight	400kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.